

HY101双组份有机硅灌封胶

产品名称	HY101双组份有机硅灌封胶
公司名称	厦门市宏骐复合材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门翔安区火炬高新区建业楼B座902-904
联系电话	0592-6284855 15080303275

产品详情

详细说明 产品介绍 HY101是双组份缩合型有机硅密封材料，可常温固化，固化过程中放出乙醇分子，对PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC、铜线等材料不会产生腐蚀。对大部分电子配件材料（PP、PE除外）附着力良好。产品特点 ?低粘度，流平性好，比重轻，不粘灯，可机器灌胶。

?产品属于脱醇反应对LED产品套件不产生腐蚀。

?耐热性、耐潮性、耐寒性优秀，应用后可以延长电子配件的寿命。

?可拆卸性，密封元器件可取出更换，再灌胶修补不留痕迹。

?本产品无须使用其它的底漆，对PC(Polycarbonate), Epoxy等材料具有出色的附着力。 ?完全固化后的材料绝缘防潮、防霉、耐酸碱、耐紫外线、抗老化性能好，耐高低温(-55-200 能长期稳定工作

?完全符合欧盟ROHS指令要求。 典型用途 ?户内外LED显示屏的灌封保护，电子元器件模块灌封。

使用方法及注意事项 ?混合之前，组份 A需要利用手动或机械进行在转速1500-2000转/分的条件下搅拌5-10分钟。搅拌器应置于液面中心稍偏位置，搅拌器插入胶内深度为胶液高度1/2-2/3最好（以距液面高度为基准）。组份B应在密封状态下充分摇动容器，然后再使用。

?当需要附着于应用材料上时，使用前请确认是否能够附着，然后再应用。 ?混合时，一般的重量比是 A : B = 10 : 1，如果需要改变比例，应对变更混合比例进行简易实验后应用。一般组分B的用量越多，固化时间越短，操作时间越短。 ?环境温度越高，固化越快，操作时间越短。一般不建议加热固化，以免表面及内部产生针孔或气泡，影响美观及密封性能。 技术参数 混合前物性（25 ，65%RH）组分

HY101A HY101B 颜色 黑色 半透明溶液 粘度 (cP) 1200-1500 100 - 150 比重 1 . 1-1.05 0.98

混合后物性（25 ，65%RH）混合比例(重量比) A : B = 10 : 1 颜色 黑色 混合后粘度(CP) 600-800

操作时间 (min) 30 ~ 50 (快) 60 ~ 90 (慢) 初固时间 (h) 2 ~ 4 (快) 4 ~ 6 (慢) 完全硬化时间 (h) 24

固化7 d, 25 ，65%RH 硬度 (Shore A) 5-10